



# DPAK (TO-252)

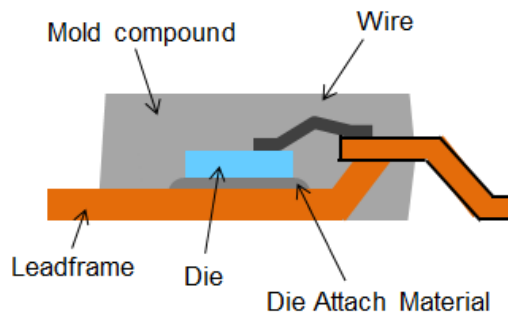
## Standard Materials

- ▶ リードフレーム：Cu（ワイヤボンディング領域にNiめっき）
- ▶ ダイアタッチ：Pbはんだ
- ▶ インターコネクト（max）：Alワイヤ 11.8 mil
- ▶ モールド樹脂：ハロゲン

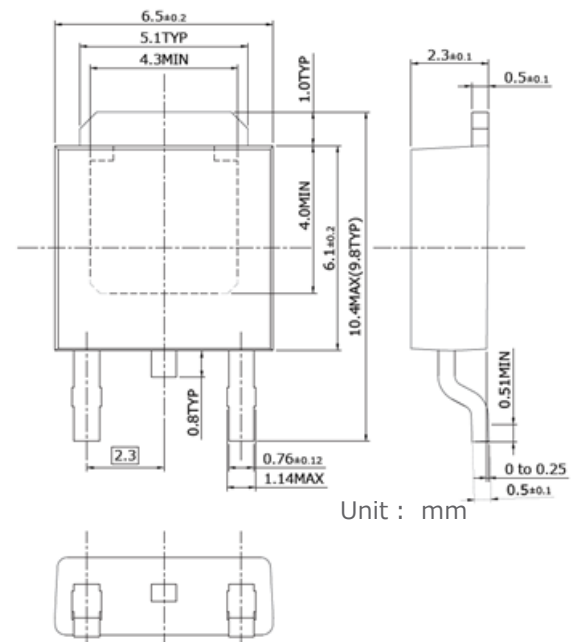
## Shipping

- ▶ テープ&リール
  - ▷ 2000pcs/リール
  - ▷ テープ幅 10.7 mm
  - ▷ リールΦ = 330 mm
- ▶ バーコードラベル

## Cross-section



## Package Outline Drawing



## Top & Bottom View



詳細については[amkor.com](http://amkor.com)にアクセスしていただくか、または[sales@amkor.com](mailto:sales@amkor.com) までメールをお送りください。

本文中の情報に関して、Amkorはそれが正確であることまたは係る情報の利用が第三者の知的権利を侵害しないことについて、如何なる保証も致しません。Amkorは同情報の利用もしくはそれに対する信頼から生じた如何なる性質の損失または損害についても責任を負わないものとし、また本文書によって如何なる特許またはその他のライセンスも許諾致しません。本文書は、如何なる形でも販売の標準契約条件の規定を超え、如何なる製品に対しても、Amkorの保証を拡張させ、または変更することはありません。Amkorは通知することなくいつでもその製品および仕様に変更を行う権利を留保します。Amkorの名前とロゴはAmkor Technology, Inc.の登録商標です。記載されている他の全ての商標はそれぞれの会社の財産です。© 2020 Amkor Technology, Incorporated. All Rights Reserved. DS414D-JP

Rev Date: 01/20

